

앰코테크놀로지 개요



경영 철학

엠코는 고객의 성공과 함께 성장해 가는 동반자입니다.

첨단기술의 리더

회사 소개

1968년 설립된 엠코는 지속적인 혁신과 성장을 통해 세계 유수의 300여개 반도체 기업들이 신뢰하는 비즈니스 파트너로 자리매김하였습니다. 엠코의 가장 큰 강점은 반도체 패키징 양산에 있어 독보적인 기술과 풍부한 경험, 업계가 직면한 기술 난제를 해결하는 능력입니다.



고도화된 제품에 대한 고객의 요구를 충족하기 위해서는 시스템 성능을 좌우하는 반도체 패키징이 매우 중요합니다. 엠코는 첨단 반도체 패키징 설계, 어셈블리 및 테스트 분야의 글로벌 리더로서, 고객의 혁신적인 기술이 현실화 될 수 있도록 지원하겠습니다.

엠코의 제품 포트폴리오

엠코는 1,000개 이상의 패키지 형태와 사이즈를 제공하는 동시에, Through-hole 및 Surface Mounting용 IC Leadframe 부터 HPC(High Pin Count)와 고밀도 애플리케이션(High Density Applications)에 필요한 Chip Scale Packages(CSP), Ball Grid Array(BGA) 솔루션에 이르기까지 다양한 제품을 생산하고 있습니다.

또한, Stacked Die, Wafer Level, MEMS, Flip Chip, Through Silicon Via(TSV) 및 2.5/3D 패키징 등 폭넓은 포트폴리오를 통해 수많은 고객들에게 특화된 서비스를 제공하고 있으며, 전통적인 패키지부터 첨단 System in Package(SiP) 솔루션에 이르기까지 패키징 요구사항을 모두 충족하고 있습니다. 따라서 고객은 고품질 패키징 및 테스트는 엠코에 맡기고 반도체 설계와 웨이퍼 가공에 집중할 수 있습니다. 엠코는 패키징 기술의 리더이자 테스트 파트너로서 늘 고객과 함께 합니다.

제품 출시 기간 단축

엠코는 전 세계 주요 전자제품 제조 지역에 총면적 100만㎡ 이상에 달하는 생산설비와 연구개발센터, 영업사무소를 보유하고 있습니다. 엠코는 이 광범위한 글로벌 네트워크를 활용하여 고객의 대량 주문을 신속하게 처리하면서 고객 만족을 실현하고 있습니다.

반도체 IC 패키지 설계 서비스

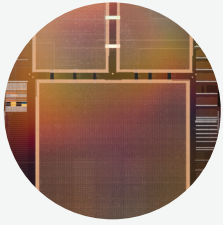
엠코는 기판 및 소프트웨어 공급업체와 긴밀히 협업하여 차세대 패키지 설계에 박차를 가하고 있습니다. 엠코의 설계 엔지니어들은 최신 설계 툴과 반도체 패키징 기술에 대한 경험이 풍부한 전문가들로 구성되어 있으며, 엠코는 세계 최고 수준의 설계 센터를 통해 설계 시간을 단축하고 전문적인 서비스를 고객에게 제공합니다.

제품 및 서비스

반도체 패키징

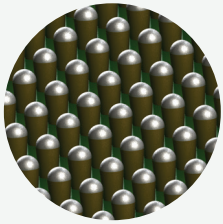
소비자들은 작고 저렴하지만 더 좋은 기능과 성능을 갖춘 반도체 제품을 원합니다. 앰코는 소비자의 이러한 요구를 충족하는 반도체 패키징 및 테스트 솔루션을 개발하면서 업계를 선도하고 있습니다.

제품 소개



2.5/3D – THROUGH SILICON VIA

Through Silicon Via(TSV) 기술은 다양한 2.5D 및 3D 패키징 애플리케이션과 아키텍처에 적용되고 있습니다. TSV 기술을 통해 고성능 및 에너지 효율을 구현하고 있습니다.



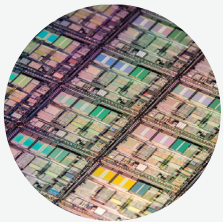
FLIP CHIP

앰코는 Flip Chip 기술의 선두주자가 되기 위해 최선을 다하고 있으며, 한국, 대만, 중국에 Flip Chip 생산설비를 보유하고 있습니다.



POWER DISCRETES

Advanced Power Packaging, Advanced Copper Clip Attach와 모듈을 포함하는 앰코의 고성능 Power Discrete는 전력에 민감한 모바일 애플리케이션에 최적화된 패키지입니다.



SYSTEM IN PACKAGE (SiP)

집적도 향상, 비용 절감에 대한 관심과 더불어 완벽한 시스템 구성에 대한 반도체 업계의 인식이 높아지면서 System in Package(SiP) 솔루션 채택이 증가하고 있습니다.



WAFER LEVEL PACKAGING

앰코는 Fan-out, Chip Scale, 3D, System in Package (SiP)에 이르기까지 폭넓은 웨이퍼 레벨 패키지 기술력과 생산능력을 보유하고 있습니다.

어셈블리

세계 최고 수준의 양산능력을 보유하고 있는 앰코는 무연 및 친환경 소재를 사용한 와이어본딩과 Flip Chip 등 다양한 패키징 솔루션 포트폴리오를 제공합니다.

파이널 테스트 서비스

파이널, 시스템 레벨, 웨이퍼 & 스트립 테스트 등 다양한 반도체 테스트 서비스와 제품 선적을 포함한 후공정 서비스를 완벽하게 제공합니다.



물류 및 재고 관리

앰코는 전 세계 고객들이 원하는 다양한 형태의 반도체 패키지를 제공합니다. 또한, 테이프 & 릴(Tape & Reel), 드라이팩(Dry Pack)을 제공할 뿐 아니라 제품을 세계 각지 고객들에게 직배송(Drop Ship)할 수 있는 물류 시스템을 갖추고 있습니다.

시장 변화에 대비

집적회로의 3D 적층과 같은 첨단 기술의 적용이 증가하면서 반도체 패키징 기술 또한 더욱 고도화되고 있습니다. 고객들은 엔드투엔드(End-to-End) 솔루션으로 광범위한 제품설계의 요구사항을 충족하는 앰코를 파트너로 선택하고 있습니다.

글로벌 네트워크

미국 본사

Amkor Technology, Inc.
2045 E Innovation Circle
Tempe, AZ 85284
USA
전화: 1-480-821-5000
팩스: 1-480-821-8276

미국 영업 사무소

San Jose, CA
Amkor Technology, Inc.
25 Metro Drive, Suite 700
San Jose, CA 95110
USA
전화: 1-408-496-0303
팩스: 1-408-496-0392

Irvine, CA
Amkor Technology, Inc.
16795 Von Karman Avenue
Suite 260 Irvine,
CA 92606 USA
전화: 949-724-9370
팩스: 949-724-8925

San Diego, CA
Amkor Technology, Inc.
5465 Morehouse Drive
Suite 210 San Diego,
CA 92121 USA
전화: 858-320-6280
팩스: 858-622-1841

Boston, MA
Amkor Technology, Inc.
105 Central Street
Suite 2300 Stoneham,
MA 02180 USA
전화: 781-438-7800
팩스: 781-438-8414

Austin, TX
Amkor Technology, Inc.
8140 N. Mopac
Suite 150 Austin,
TX 78759 USA
전화: 512-953-0701
팩스: 512-953-0717

EMEA 영업 사무소

Amkor Technology Holding
B.V., Germany
Werner-Eckert-Straße 8
81829 Munich
Germany
전화: 49-(0)89-1241498-40
팩스: 49-(0)89-1241498-49

중국 영업 사무소

Amkor Technology Shanghai
Zhangjiang Hi Tech Park
Bldg. E, Chamtime Square
2889 Jinke Road
Room #504, Pudong,
Shanghai 201203
China
전화: 86-21-5064-4590
내선번호: 2340, 4034, 4221, 4245
팩스: 86-21-5048-2522

일본 영업 사무소

Amkor Technology Japan, Inc.
Shiba-Koen Front Tower 14F
2-6-3, Shibakoen
Minato-ku, Tokyo 105-0011
Japan
전화: 81-3-5425-2830
팩스: 81-3-5425-2831

한국 영업 사무소

Amkor Technology Korea, Inc.
인천광역시 연수구
송도미래로 150, 21991
대한민국
전화: +82-32-728-4114

동남아시아 영업 사무소

Amkor Technology Singapore
Holding Pte. Ltd.
Valley Point Office Tower
491B River Valley Road
#12-03
Singapore 248373
전화: 65-6211-3333
팩스: 65-6211-3388

대만 영업 사무소

Amkor Technology Taiwan Ltd.
3F-1, No.1, Tai Yuen 2nd St.
Zhubei City, Hsinchu County
Taiwan 302
전화: 886-3-598-2000
팩스: 886-3-560-1269



보다 자세한 사항은 홈페이지 amkor.com을 방문하시거나 sales@amkor.com으로 문의하여 주시기 바랍니다.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 앰코는 제공된 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다. © 2022 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. BR302G-KR Rev Date: 01/22